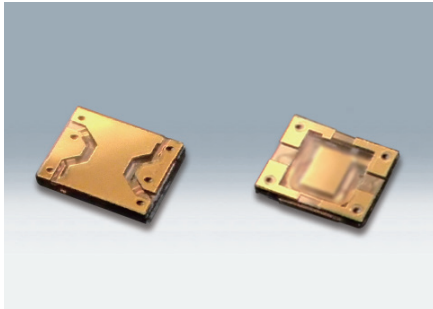


表面贴装型晶体谐振器/MHz带晶体谐振器

DX1008JS



实际尺寸 □

■ 优点

- 1008尺寸、厚度0.12mm
采用全新结构,行业首创的超薄设计
- 不使用陶瓷基底,只由晶体与金属膜构成
- 不使用有机性导电性粘合剂,长期抗老化性能出色
- 通过在真空中组装来降低异物风险

■ 用途

- 移动通信设备、近距离无线模块
- 可穿戴设备
- 车载多媒体设备



■ 一般规格

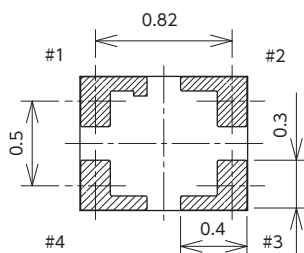
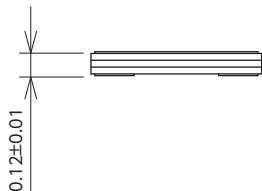
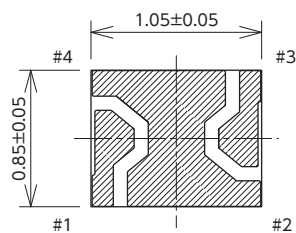
项目	DX1008JS		
频率范围	48 ~ 52MHz	52 ~ 96MHz	96 ~ 120MHz
谐波次数	Fundamental		
负载电容	8pF, 10pF, 12pF		
激励电平	10 μW (100 μW max.)		
频率公差	±20×10 ⁻⁶ (at 25°C)		±100×10 ⁻⁶ (at 25°C)
串联电阻	100Ω max.	60Ω max.	40Ω max.
频率温度特性	±30×10 ⁻⁶ / -30 ~ +85°C (Ref.To 25°C)		
保存温度范围	-40 ~ +85°C		
包装单位 (1)	3000pcs./reel (φ 180)		

(1) 无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level : LEVEL1 (IPC/JEDEC J-STD-033)

有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。

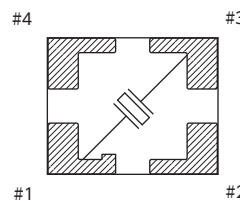
[mm]

■ 外形尺寸



■ 内部连接

<Top View>



■ 焊盘图形 (参考)

<Top View>

